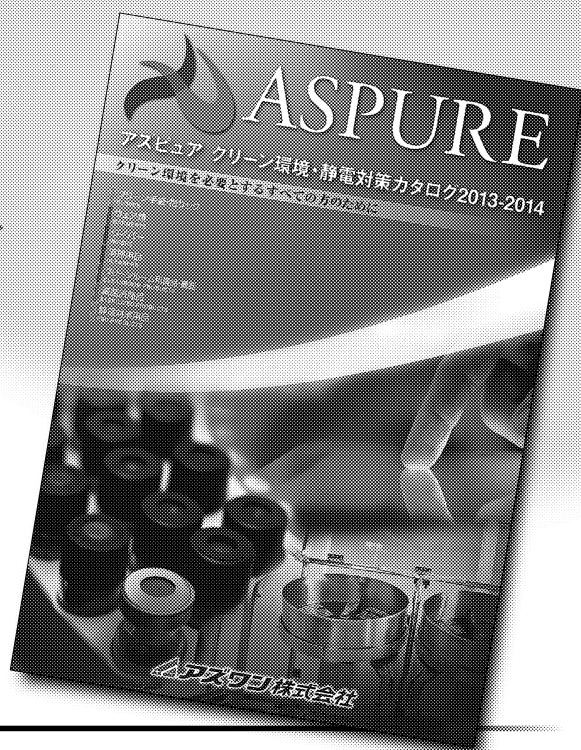


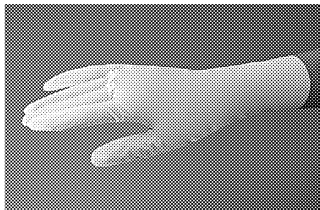
アズピュア クリーン環境・ 静電対策カタログ 2013-2014

クリーン環境を必要とする
すべての方のために

クリーン環境のための商品約300アイテムを
掲載しております。
ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。



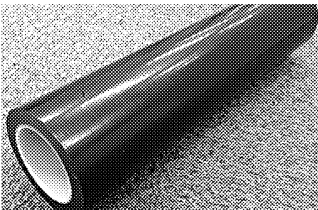
新商品、新たなラインアップも続々登場!



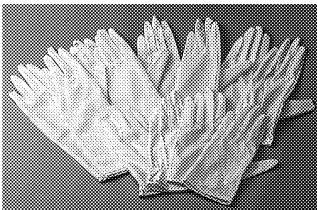
シームレス(無縫製)手袋
SS、LLサイズを追加



帯電防止マット
エコノミータイプが新登場



装置保護フィルム
(幅:510mm、1020mm)
新登場



防塵手袋
各種 新登場 ナイロン製、
メッシュタイプ、etc

アズワン株式会社

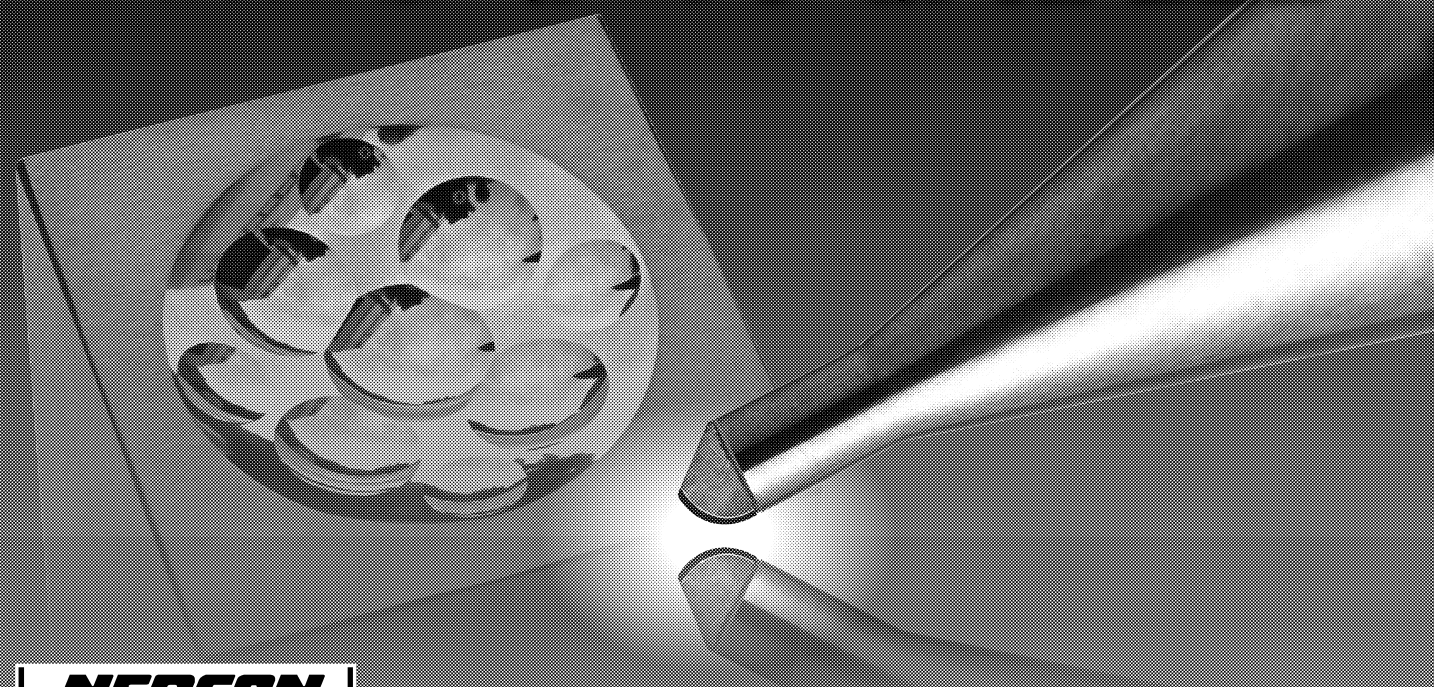
大阪/〒550-8527 大阪市西区江戸堀2-1-27 TEL.06-6447-8601 FAX.06-6447-8651
東京/〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-12-4 TEL.03-3249-3815 FAX.03-3249-3825
<http://www.as-1.co.jp>

Ingenious Dynamics

ナノ多結晶ダイヤモンド工具

スミタヤ
バイナルス

ボールエンドミル NPD8型



NEPCON 2014 JAPAN
R&D and Manufacturing
会期: 2014年1月15日(水)~17日(金)
会場: 東京ビッグサイト
弊社ブースNo. 東22-15

超硬合金材の直彫り仕上げ加工に最適!

住友電気工業株式会社

製造元: ◆住友電気ハードメタル株式会社

フリーダイヤル 110番
0120-159110
9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ハードメタル事業部 〒664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1 TEL.(072)772-4531 FAX.(072)772-4595
グローバルマーケティング部 〒664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1 TEL.(072)772-4535 FAX.(072)771-0088

TOKYO NAGOYA OSAKA

東京営業グループ ☎(03)6406-2635 名古屋営業グループ ☎(052)933-9841 大阪営業グループ ☎(06)6221-3600
流通販売部 東京市販グループ ☎(03)6406-2636 名古屋市販グループ ☎(052)963-2880 大阪市販グループ ☎(06)6221-3700

――>> 切削工具の最新情報を発信中 <<―― <http://www.sumitool.com>

山本鍍金試験器

山本鍍金試験器はメッキ用試験器・分析器の専門メーカー。品質管理から研究開発まで、先端技術に欠かせない実験装置を手掛け60年、バイオ・医学などさまざまな分野に商品を提供する。

今回の展示会では簡易型の「シリコンウェハ用めっき実験装置キット」を中心に展示する。20から120mmまでに対応、半導体・MEMS・マイクロマシンなどに精密メッキが行える。特殊な水槽に専用の陰陽極治具を備え、生産設備としての対応も可能で目的とするメッキ条件の割り出しや試作、少量生産に適している。また、太陽電池用など顧客ニーズに合わせた数多くの特注品製作実績も持っている。

その他、ハルセル試験器・小型バレルメッキ装置などピコレベルから100μ程度の小型メッキ実験装置まで、メッキを新たに始める人にも扱いやすい製品を多数取りそろえている。

奥野製薬工業

奥野製薬工業は次の製品・技術を出展する。トッブルナシリシリーズの「DTF(スルホホルフィン用)」「EV/HV/VT(ヒアフライン用)」「SV(TSVフライン用)」「HT(高スロイングパワータイプ)」の各硫酸銅メッキ添加剤など、独立回路基板用の「トップパラス(Pd/Auめっき)」「トップシルベ(Ni/Au・Ni/Pd/Auめっき)」「トップNPG(Ni/Pd/Auめっき)」などの各プロセス提案も行う。

また、会期中11時と14時にプレゼンテーションも実施。内容は次の通り。15日「TOPCカッパーHFS(低応力・高被膜屈曲性無電解銅めっき液)」16日「CFP4010BK(クロムフリー黒色無機顔料)」17日「トップMRS(L ED照明用積層構造)プロセス」。

サーマプレジジョン

サーマプレジジョンはハイエンドのパッケージ基板用途向けに硫酸銅メッキの添加剤を自動分析可能な「AC2000(米ECIテクノロジ製)」と、次世代の高精度・高密度パッケージ基板向けウエットプロセス向け装置(台湾アンボック・フアイエス社製)の新製品を出展。AC2000は従来、オペレーターが基板の製造ラインにおいて手動での検査を完全に自動化することで、ヒューマンエラーやデータ入力ミスによる歩留まり悪化を排除。また、微細な回路形成に対応して縦型搬送を採用したウエット工程向け装置の国内販売にも注力。2014年中に台湾に試作・評価用ラインも整備し、日系顧客に売り込み、L/Sで20μm以下の細線化に対応した薄物パッケージ基板の製造ラインの導入を目指す。さらに、モニター機能を標準搭載したルーター装置を展示する。

W I T

特に車載・産業機器マーケットでは光学式自動外観検査(AOI)とセットで運用されるのが一般常識となりつつある目視支援装置「EIP3000」の新たな運用方法として、WITは不良流出ゼロを目指す「基板修理工程」の実演を行う。

新規開発の「基板反り補正機能」など目視検査員の不良見逃し防止機能の進化に加え、不良情報を最大限に活用して過去を看過されてきた基板修理工程における不良情報伝達漏れ・修理漏れをシャットアウトする。

さらに、全ての修理箇所の画像を含む情報を基板ごとに保存し、不良・修理情報の管理システムとしても活用できる。単なる製造工程で運用される目視支援装置としてではなく、検査情報を基板修理工程で有効活用することにより、真の不良流出ゼロを実現する一連のフローが体感できる実演展示となる。

エレクトロテスト ジャパン

半導体パッケージング技術展

上村工業

上村工業はパッケージ向けにロフロファイル樹脂向けスミアプロセス・アップデスプロセス・電解再生システムや、スルカフシリートの「PEAVER4(ビルドアップ用無電解銅めっき液)」「EVEFV2(ヒアフライン用電気銅めっき添加剤)」「ETF(スルホホルフィン用電気銅めっき添加剤)」のほか、「ソフトアロイGLK06(小径フリップチップパッドへのめっき法による接合金属の供給)」などを紹介する。ウェハー向けにはエタスシリーズの「PHP(中性無電解銅めっき液)」「EWFIS(TSV用電気銅めっき添加剤)」「ETW(ボストめっき用電気銅めっき添加剤)」や、電極パッド用表面処理プロセスの「UBM」などを出展予定。新装置「UirVPS(垂直連続搬送めっき装置)」も提案する。

大和化成

大和化成は今回新たに有機酸スズメッキ用の25%スズ塩溶液「ダイニンググッドS25」を出展する。「ダイニンググッド300プロセス」に合わせた高濃度スズ塩を開発した。くみ出しや補給の多いバレルメッキを中心に、トータルコストの削減につながるメリットをユーザーに提案していく。

同社の主力製品であるスズメッキ用添加剤「ダイニンググッドシリーズ」についても高速仕様などの新製品を紹介する。また、ノンアン銀メッキ「ダイニングハイプロセス」では従来のラインアップに加え、高光沢被膜が得られる「ダイニングハイGPEHB」を開発している。無光沢から高光沢まで用途に応じた幅広い仕様の製品をユーザーに提案する。

J C U

JCUはウェハー用高速バンブメッキプロセス「J SOLDER BUHD」「CURBRITE BUHD」および基板用高速銅バンブ「CPOS」を展示する。同プロセスの特徴は面均性を損なわず高電流密度での「SNAgeバンブ」「CUBAN」形成が可能となり、従来品と比較してメッキ処理時間短縮による生産性の大幅な向上を実現。添加剤成分は分析ができ安定した数値管理が可能である。また「CPOS」はバンブのトップ形状は平坦性に優れたフラットな形状が得られることが特徴である。

その他、新しいシアン金メッキプロセスとしてプリント基板や半導体ウェハー、電子部品など幅広い用途で利用可能な「RARE SYNTHESIS GOLD2」プロセスなどを展示する。

レーザーテック

レーザーテックはレーザーとカラーコンフォーカルの二つの光学系を1台に搭載した新型マイクログラフ「OPTELICS HYBRID」をデモ展示する。

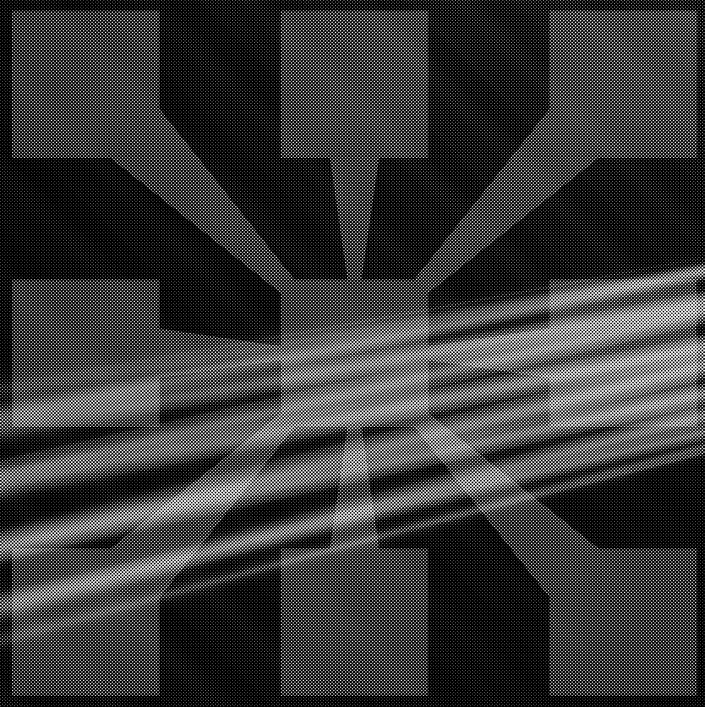
カラーコンフォーカル顕微鏡とレーザー顕微鏡のそれぞれの特徴を1台で実現させたことで、高精度カラー・広視野と高倍率・高分解能を両立させることも、一般的なレーザー顕微鏡、デジタルマイクログラフ、光干渉形状測定器の測定範囲をこの1台でカバーできる。

半導体材料、透明膜、コーティング材料、各種フィルム、金属部品、プラスチック加工部品など、さまざまな材料でできたサンプルの観察や測定が可能だ。初心者でも使える簡単操作ガイドダンスを装備し、自動測定、自動全面検査ソフトなどのオプションも充実している。

サーマプレジジョンのシームレス・ソリューションは、「シンプル＆ハイクオリティ」。

ますます拍車のかかる高度化。それに伴い複雑化するシステム＆サービス。だからこそ、今、開発から製造、そして販売の現場状況を知り、トータルでのシームレス化を提供できる企業が必要なのです。

サーマトロニクス貿易株式会社と株式会社目白プレジジョンは、各業界の求める「シンプル＆ハイクオリティ」の実現を目指し12月1日から「株式会社サーマプレジジョン」として先進のシームレス・ソリューションを提供します。



Cerma Precision, Inc.

ネフコン ジャパン2014 内

半導体パッケージング技術展

ICP

ブースNo.東4hall 40-4

2013年12月1日、サーマトロニクス貿易(株)と株式会社目白プレジジョンは経営を統合し、「株式会社サーマプレジジョン」としてスタート致しました。

※株式会社サーマプレジジョン 本社:〒136-0076 東京都江東区南砂2-36-10 Tel. 03-5653-5881 支所:〒135-0041 東京都江東区冬木16-1 Tel. 03-3643-2921 <http://www.cerma.co.jp/>